

浙江省半导体行业协会

关于邀请参加“2026 杭州国际半导体与集成电路产业创新展览会”的函

致各有关单位：

为进一步促进半导体与集成电路领域创新链与产业链深度融合，推动我国半导体产业高质量发展，在中华人民共和国商务部批准下，由浙江省半导体行业协会与上海高登会展集团有限公司联合主办、中国国际科技促进会半导体产业发展分会协办的“2026 杭州国际半导体与集成电路产业创新展览会”，定于 2026 年 5 月 14 日至 16 日在杭州大会展中心隆重举办。

本届展会规划展览面积 3 万平方米，将集中展示全球半导体与集成电路领域的前沿技术与创新产品，覆盖集成电路设计、EDA、芯片制造、封装测试、装备及零部件、半导体材料、系统应用等全产业链关键环节，全方位展示中国尤其是长三角地区半导体与集成电路全产业链的创新成果。展会采取“展览+论坛+对接+应用”多维融合模式，同期将举办多场高端论坛与专题活动，包括长三角集成电路产业协同创新发展高峰论坛、浙江省半导体行业协会会员大会、浙江省集成电路产业链协同对接活动（涵盖具身智能人形机器人、新能源汽车、高端医疗等需求发布会及产

业链对接等),旨在为业界搭建关键技术交流、发展趋势探讨与产业应用对接的平台,促进前沿动态分享、创新人才汇聚与技术合作深化,推动构建协同共生的产业生态。

组委会热忱欢迎各地方主管部门和行业组织相关负责人莅临指导,参与开幕式及相关重要活动,并诚邀组织本地企业组团参展参会,共拓商机、共谋合作、共促发展,助力半导体产业链上下游协同创新与融合发展。

附件:展会基本信息



附件：1.展会基本信息

一、展览名称及主题

2026 杭州国际半导体与集成电路产业创新展览会

展会主题：“链接芯生态，智创新机遇”

二、时间与地点

展会时间：2026 年 05 月 14-16 日

展会地点：杭州大会展中心-浙江

三、组织机构

批准单位：中华人民共和国商务部

主办单位：浙江省半导体行业协会

上海高登会展集团有限公司

协办单位：中国国际科技促进会半导体产业发展分会

承办单位：上海大道国服展览有限公司

四、展出大类

展品范围涵盖集成电路设计、EDA、芯片制造、封装测试、装备及零部件、半导体材料、系统应用等产品和技術。

五、收费标准

展位类别	室内光地（特装）	标准展位
国内企业	1600 (RMB) /m ² /展期	16800 (RMB) /个 /展期
国外企业	480 (USD) /m ² /展期	4800 (USD) /个 /展期

注：“室内光地”最少 36 平方米起租只提供参展空间，不包括展架、展具、地毯、电源等。（双开口展位需加 20%服务费。）

六、展会期间活动安排

时间	内容
5月13日 下午	参会嘉宾与人员前往会议酒店报道
5月14日 上午10点	2026杭州国际半导体与集成电路产业创新展览会开幕式 政府领导致辞、各国驻华使节致辞、参展商代表发言、展会开幕等，时长30分钟。领导及行业代表巡馆40分钟。
5月14日 下午	长三角集成电路产业协同创新发展大会 特邀院士专家与行业精英齐聚一堂，凝聚长三角集成电路产业协同发展共识，深化产业链协同创新，激发长三角集成电路产业一体化发展的新动能。
5月15日 上午	浙江省半导体行业协会会员大会 以“凝聚行业力量，促进高质量发展”为主题，总结年度工作、规划未来发展，权威发布《浙江省集成电路产业发展年度报告》，分析全省产业运行态势、研判产业态势与前景，并为会员单位创造深度交流与合作的重要契机。
5月15日 下午	浙江省集成电路产业链协同对接活动 围绕EDA工具、RISC-V、特色工艺、先进封装等关键环节以及供应链安全议题，组织产业链上下游企业共同研讨技术路线与协同创新方案。邀请行业主管部门深入解读国家及浙江省最新半导体产业政策、扶持措施与发展规划。
5月16日 上午	具身智能机器人、新能源汽车与高端医疗供需对接会 具身智能、新能源企业、工业控制和高端医疗等整机和系统应用需求方与参展企业开展面对面的对接交流，发掘供需产业链合作的新潜能，打造“集成电路+X”跨产业链的核心力量。
5月14-16日 展览开放日	新产品发布和产业园区推介 举办多场地方产区推介会、招商政策解读以及产品首发等

七、报名参展参会

请各有关单位收到通知后，积极报名参展参会。各参展单位请认真填写参展申请表和参会报名表在2026年03月31日前传真或邮件发送至组委会办公室秘书处。

八、会务组联系方式：

浙江省半导体行业协会

电 话：0571-88409702

联系人：骆萍萍 15958177633

邮 箱：407518168@qq.com

参展及商务合作事项联系

电 话：021-64396190

传 真：021-50131761

联系人：杨 铭 13661576689

龚雪娟 13651949391

邮 箱：info@goldenexpo.com.cn

附件：2. 参会回执表

参会回执表

填报单位（盖章）：

填报日期： 月 日

单位名称	中文：				
	英文：				
代表姓名	性别	部门	职位	手机	电子邮件
会议联络人：					
<p>会议赞助（以下为部分赞助形式，更多形式及赞助详情欢迎来电垂询） 协办赞助 <input type="checkbox"/> 赞助 <input type="checkbox"/> 发言 <input type="checkbox"/> 讨论 <input type="checkbox"/> 会场广告 <input type="checkbox"/> 胸牌纸袋</p>					
<p>会务费： 国内企业 2880 元/位 国外企业：1280 美金/位 （含展会期间 3 天会议期间的服务费、资料等，不含住宿）。 注：各国政府官员、驻华（沪）机构参赞以上的外交官与各省（市）县相关领导参会免费。</p>					
<p>参会金额：我单位共有 _____ 位代表参会，总计费用 _____</p>					
<p>为了使会议更为专业更贴近企业需求，请您填写以下事项： 您关注的话题： _____</p>					
<p>您想见的企业或嘉宾： _____</p>					
<p>注：各国政府官员、驻华（沪）机构参赞以上的外交官与各省（市）相关县领导抵达地点及时间</p>					

附件：3. 参展报名申请表

参展报名申请表（代合同）

如欲参加“SICE2026-杭州国际半导体与集成电路产业创新展”请将本表认真填写
 传真：021-50131761 或电邮：info@goldenexpo.com.cn 以便组委会的工作统一安排。

企业名称	中文：		
	英文：		
地 址		邮 编	
电 话		传 真	
负 责 人	(职位：)	手 机	
邮 箱		网 址	
参展项目	1) 选项 1：国际标准展位与室内光地 <input type="checkbox"/> 室内面积_____展位号_____ 费用 (RMB) _____ <input type="checkbox"/> 标准展位_____展位号_____ 费用 (RMB) _____ 特殊要求：_____。		
	2) 选项 2：《展览会会刊》尺寸：140 毫米(宽)×210 毫米(高) <input type="checkbox"/> 封 面： 50000 (RMB) <input type="checkbox"/> 封 底： 40000 (RMB) <input type="checkbox"/> 封 二： 30000 (RMB) <input type="checkbox"/> 封 三： 20000 (RMB) <input type="checkbox"/> 彩色整版： 12000 (RMB) <input type="checkbox"/> 黑白整版： 6000 (RMB)		
	3) 选项 3：广告与赞助商机 <input type="checkbox"/> 门票 <input type="checkbox"/> 胸牌 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 其它，共计_____ (RMB)。 有关赞助商机及现场广告阵地相关事项，请详询主办方。 费用总额： (大写)_____ (小写) ¥ _____ 此款项于签订合同后三个工作日内汇出，请查收。		
总计费用			
备注及特殊要求：			
展会指定收款账户 户名：上海大道国服展览有限公司 账号：444289275927 户行：中国银行上海市外高桥保税区支行		申请单位名称： (盖章) 负责人签字： _____ 年 月 日	

组委会联系方式：

地 址：上海市浦东新区启帆路 519 号森兰美奂北楼 C 座 1006 室（201208）

电 话：021-64396190 50131760 传 真：021-50131761

联系人：杨 铭 龚雪娟

E-mail：info@goldenexpo.com.cn